

---

# 第 53 回地盤工学研究発表会

---

## 技術展示コーナー募集要項

Ver.2.0

会期：平成 30 年 7 月 24 日(火)～7 月 26 日(木)

会場：サンポートホール高松（高松市）

公益社団法人 地盤工学会

## ご挨拶

---

拝啓

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は地盤工学会の活動に、格別のご支援・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、地盤工学会では、平成30年7月24日(火)～7月26日(木)に香川県高松市において、第53回地盤工学研究発表会を開催します。約2,000人の関係者が全国から集まり、地盤工学に関する最新の研究・技術の発表が行われます。

地盤工学分野では、新しい施工法、材料、調査法、試験法、設計法、解析法、防災・環境保全など優れた技術が各機関・各企業で開発されています。その一部は、今回の研究発表会で発表されますが、さらに深く紹介する場も必要となっています。

そのため、各機関・各企業の優れた技術を紹介していただく場所として、「技術展示コーナー」を企画いたしました。これによって、地盤工学会会員のみならず、一般市民や学生を含めた方々への地盤工学分野の知識向上や拡大につながることを期待されます。

つきましては、貴機関・貴企業におかれましては、来る第53回地盤工学研究発表会(高松大会)の「技術展示コーナー」に出展していただきたく、ご案内申し上げます。応募方法につきましては、「募集要項」をご覧くださいの上、是非ともご出展いただきますようお願い申し上げます。

敬具

公益社団法人 地盤工学会

第53回地盤工学研究発表会実行委員会  
実行委員長 長谷川修一

# 技術展示コーナー 募集要項

## 1 . 開催要旨

第 53 回地盤工学研究発表会における研究発表に加えて、各機関・各企業の優れた技術を紹介する場として、「技術展示コーナー」を企画します。

一般・学生の皆様にも広く参加を呼びかけ、技術展示コーナーに多くの方々に来場していただき、地盤工学を知っていただく機会づくりを目指します。

## 2 . 出展期間

平成 30 年 7 月 24 日(火) 8:40～18:30

7 月 25 日(水) 8:40～17:30

7 月 26 日(木) 8:40～15:00

搬入設営：7 月 23 日(月) 14:00～18:00

搬出撤去：7 月 26 日(木) 15:00～17:00

研究発表会のプログラムに応じて時間帯を変更する場合がございます。

## 3 . 会場

サンポートホール高松 1 階「展示場」他 (〒760-0019 香川県高松市サンポート 2-1)

最大予定ブース数：50 ブース

## 4 . 出展料金

1 ブース：300,000 円 (税込), 2 ブース：500,000 円 (税込)

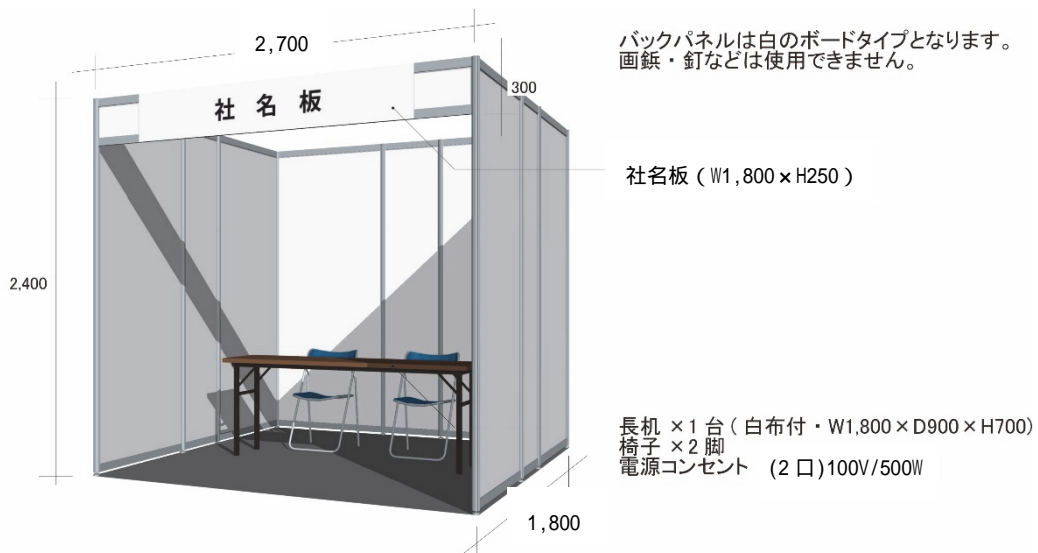
3 ブース以上の場合は、お問い合わせください。

## 5 . 基礎小間仕様

サイズ 横幅 W2,700mm × 奥行 D1,800mm × 高さ H2,400mm

(D は 1,800mm (パネル 2 枚分) + 600mm (スペース出し) が可能)

標準備品 長机 (白布付) 1 台・椅子 2 脚・社名板・蛍光灯 1 台・電源 100V/500W



## 6 . 出展特典

出展者には、以下の特典がございます。

研究発表会 DVD 1 枚 , 研究発表会参加証 1 名分 ,  
「技術展示のしおり」の印刷および配布 ( 研究発表会参加者に総合受付で配布 )

## 7 . オプション備品レンタル

下記にオプション備品を例示いたします。

その他の備品も手配が可能ですのでお問い合わせください。

長机 ( W1,800 × D600 × H700 )	1 台 : 2,700 円 ( 税込 )
白布	1 枚 : 1,620 円 ( 税込 )
カタログスタンド ( A4 × 6 段程度 )	1 台 : 5,400 円 ( 税込 )
貴名受	1 台 : 2,160 円 ( 税込 )
アームスポットライト	1 灯 : 4,320 円 ( 税込 )
追加電源コンセント ( 2 口 100V/500W )	1 ケ : 10,800 円 ( 税込 )

## 8 . 申込方法および期間

別紙申込書にご記入のうえ、FAX にて実行委員会までお送りください。

お申し込み受付後、出展方法やお支払い方法などの詳細を別途ご連絡いたします。

申込み受付期間 : 平成 29 年 12 月 11 日 ( 月 ) ~ 平成 30 年 2 月 28 日 ( 水 )

## 9 . 出展場所

出展者のブース位置につきましては、主催者にご一任ください。

## 10 . お支払いについて

「出展申込書」を確認後、請求書をお送りいたしますので、指定日迄に下記の高松大会指定口座へお振込みください。

なお、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。

振込先口座 : 伊予銀行 城北支店 ( 普通 ) 1937191

振込先口座名 : 第 53 回地盤工学研究発表会実行委員会

## 11 . お問い合わせ先

第 53 回地盤工学研究発表会 ( 高松大会 ) 実行委員会

〒790-8577 愛媛県松山市文京町 3 愛媛大学防災情報研究センター内

地盤工学会四国支部事務局 中島淳子

TEL : 090-6881-9036 FAX : 089-927-8141

E-mail : nakajima@cee.ehime-u.ac.jp

E-mail : [nakajima@cee.ehime-u.ac.jp](mailto:nakajima@cee.ehime-u.ac.jp)

FAX : 089-927-8141

申込締切日 平成 30 年 2 月 28 日 (水)

第 53 回地盤工学研究発表会 実行委員会 行

## 第 53 回地盤工学研究発表会 技術展示コーナー出展申込書

申込日 平成 年 月 日

貴社名 : \_\_\_\_\_

ご担当部署名 : \_\_\_\_\_

ご担当者名 : \_\_\_\_\_

住所 : 〒 \_\_\_\_\_

電話・FAX : 電話 \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

メールアドレス : \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

お申込内容 (3 ブース以上の場合は、お問い合わせください。)

1 ブース 300,000 円 (税込)

2 ブース 500,000 円 (税込)

オプション備品

商品名	数量	金額
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

ご要望事項 (ご出展につきましてご要望などございましたら、下記にご記入ください。)

出展料金のご請求先

上記ご連絡先と異なる場合は、下記にご住所、ご担当部署などをご記入ください。